



本社：〒160-8366  
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号  
西新宿三井ビルディング

報告書番号： PCN#20120328001  
2012 年 3 月 28 日

## お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社  
営業・技術本部 カスタマドキュメント  
マネージャ 牧 達郎 

### HVAL/HPA u\*BGAパッケージ 一部製品 組立検査サイト変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

既にご存知のように、組立検査サイト、弊社日出工場の閉鎖について、本年 1 月に報告させていただきました。本移行対象製品に関する変更通知は、今後数週間に渡り、パッケージファミリー毎に段階的に行われます。本変更通知は、代替前処理サイトへの u\*BGA パッケージ対象製品移行に関する連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30 日以内**に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけただけのものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、現行サイト閉鎖までに新サイト製品のご評価を完了いただけますように、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90 日**以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは [pcn\\_tij@list.ti.com](mailto:pcn_tij@list.ti.com) にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Test	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	<input checked="" type="checkbox"/> Others	<input checked="" type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	HVAL/HPA u*BGAパッケージ 一部製品 組立検査サイト変更 現行 : TI-Hiji (日本) 変更後 : TI-Philippines (フィリピン)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	12月の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input checked="" type="checkbox"/> 計画	<input type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input type="checkbox"/> 変更無し	<input checked="" type="checkbox"/> 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容 : 弊社 HVAL (ハイボリュームアナログロジック)/HPA (ハイパフォーマンスアナログ) u\*BGA (96-GKE, 96-ZKE, 114-GKF, 114-ZKF, 209-GHK, 209-ZHK, 257-GHK, 257-ZHK) パッケージ 一部製品の組立検査サイトについて、現行 TI-Hiji (日本) サイトにおいて製造していますが、TI-Hiji サイト閉鎖による供給能力確保の為に、これに替えて、TI-Philippines (フィリピン) サイトに変更します。組立部材の変更はありません。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

<u>変更内容</u>	<u>現行</u>	<u>変更後</u>
組立検査サイト	TI-Hiji (日本)	TI-Philippines (フィリピン)

理由 : TI-Hiji サイト閉鎖による供給能力確保の為

詳細 :  
 検査サイトの最終出荷試験内容、条件は、現行と同一で、生産性試験により検証されます。

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

対象製品リスト

対象製品名				
74ALVCH32244ZKER	PC12050BGHK	SN74AUC32374GKER	SN74LV4320AGKFR	SN74LVCZ32240AZKER
74ALVCH32245ZKER	PC12050B1GHK	SN74AUC32374ZKER	SN74LV4320AZKFR	SN74LVCZ32244AZKER
74ALVCH32374ZKER	PC12050B1ZHK	SN74AUC32244GKER	SN74LVC32244GKER	SN74LVCZ32245AGKER
74ALVCH32501ZKFR	PC12050BZHK	SN74AUC32244ZKER	SN74LVC32244ZKER	SN74LVCZ32245AZKER
74ALVCH32973ZKER	PC12050GHK	SN74AUC32374ZKER	SN74LVC32245GKER	SN74LVT32244GKER
74ALVTH32244ZKER	PC120501GHK	SN74AVC32374GKER	SN74LVC32245ZKER	SN74LVT32244ZKER
74ALVTH32373ZKER	PC120501ZHK	SN74AVC32T245GKER	SN74LVC32373AGKER	SN74LVTH322374KR
74ALVTH32374ZKER	PC12050ZHK	SN74AVC32T245ZKER	SN74LVC32373AZKER	SN74LVTH32244GKER
74AVC32T245ZKER-P	PC12060GHK	SN74AVCB324245KR	SN74LVC32374AGKER	SN74LVTH32244ZKER
74AVCB324245ZKER	PC120601GHK	SN74AVCBH324245KR	SN74LVC32374AZKER	SN74LVTH32245GKER
74AVCBH324245ZKER	PC12060ZHK	SN74AVCH32T245KR	SN74LVCH322244AKR	SN74LVTH32245ZKER
74LVCH322244AZKER	SN74ALVCH32244KR	SN74AVCH32T245ZKER	SN74LVCH32244AGKER	SN74LVTH32373GKER
74LVCHR32245AZKER	SN74ALVCH32245KR	SN74CB3Q32245GKER	SN74LVCH32244AZKER	SN74LVTH32373ZKER
74LVTH322374ZKER	SN74ALVCH32374KR	SN74CB3Q32245ZKER	SN74LVCH32245AGKER	SN74LVTH32374GKER
74SSTUB32864AZKER	SN74ALVCH32501KR	SN74CBT32245GKER	SN74LVCH32245AZKER	SN74LVTH32374ZKER
74SSTUB32866AZKER	SN74ALVCH32973KR	SN74CBT32245ZKER	SN74LVCH32373AGKER	SN74SSTU32864CZKER
74SSTVF32852ZKFR	SN74ALVTH32244KR	SN74CBTK32245GKER	SN74LVCH32373AZKER	SN74SSTU32864ZKER
AVC32T245ZKER-D	SN74ALVTH32373KR	SN74CBTK32245ZKER	SN74LVCH32374AGKER	SN74SSTU32866ZKER
CF4320HGKFR	SN74ALVTH32374KR	SN74GTLPH3245GKFR	SN74LVCH32374AZKER	SN74SSTUB32864ZKER
CF4320HZKFR	SN74AUC32244GKER	SN74GTLPH3245ZKFR	SN74LVCHR32245AKR	SN74SSTUB32866ZKER
HPA00023GKFR	SN74AUC32244ZKER	SN74GTLPH32912ZKFR	SN74LVCR32245AGKER	SN74SSTV32852GKFR
PC11520GHK	SN74AUC32245GKER	SN74GTLPH32916ZKFR	SN74LVCR32245AZKER	SN74SSTV32852ZKFR
PC11520ZHK	SN74AUC32245ZKER	SN74GTLPH32945ZKER	SN74LVCZ32240AGKER	SN74SSTVF32852KR

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所:22L)及び製品捺印が下記の様になります。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)
現行	TI-Hiji	ASO: HIJ
変更後	TI-Philippines	ASO: PHI



図1 出荷ラベルの例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012年11月	終了	2012年12月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN74AUCH32244ZKER	-	-	
Assembly Site:	TI Philippines	Package/Code/Pins:	U*BGA/ZKE/96	
Mount Compound:	4111062	Mold Compound:	4203565	
Bond Wire:	0.96 Mils Dia., Au	Solder Ball Composition:	SnAgCu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Characterization	-	30	-	-
**Unbiased HAST	110C/85%RH, 264 Hrs	77	77	77
**T/C	-55C/125C, 200, 700 Cyc	77	77	77
Visual / Mechanical	-	328	328	328
Physical Dimensions	per mechanical drawing	30	30	30
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
X-ray	top and bottom	5	5	5
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C	12	-	-
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012年11月	終了	2012年12月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN74ALVCH32501KR	-	-	
Assembly Site:	TI Philippines	Package/Code/Pins:	U*BGA/GKF/114	
Mount Compound:	4111062	Mold Compound:	4073504	
Bond Wire:	0.96 Mils Dia., Au	Solder Ball Composition:	SnPb	
MSL:	JEDEC L-2/235C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Unbiased HAST	110C/85%RH, 264 Hrs	77	77	77
**T/C	-55C/125C, 200, 700 Cyc	77	77	77
Visual / Mechanical	-	328	328	328
Solder Ball Shear	20 balls per device, 4 devices	80	-	-
Physical Dimensions	per mechanical drawing	30	30	30
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
X-ray	top and bottom	5	5	5
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/235C	12	-	-
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/235C				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012年11月	終了	2012年12月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN74SSTV32852ZKFR	-	-	
Assembly Site:	TI Philippines	Package/Code/Pins:	U*BGA/ZKF/114	
Mount Compound:	4111062	Mold Compound:	4203565	
Bond Wire:	0.8 Mils Dia., Au	Solder Ball Composition:	SnAgCu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Unbiased HAST	110C/85%RH, 264 Hrs	77	77	77
**T/C	-55C/125C, 200, 700 Cyc	77	77	77
Visual / Mechanical	-	328	328	328
Solder Ball Shear	20 solder balls per device for 4 devices	80	-	-
Physical Dimensions	per mechanical drawing	30	30	30
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
X-ray	top and bottom	5	5	5
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C	12	-	-
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				